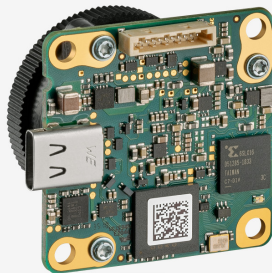
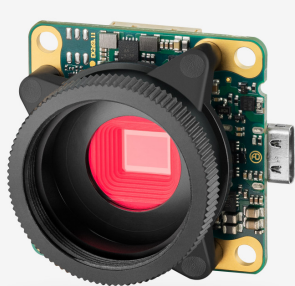


■ 양산 단계

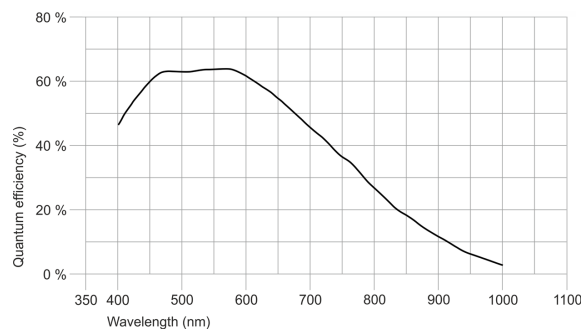
이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다.



사양

센서

센서 타입	CMOS 모노
셔터	Global Shutter
센서 특성	선형의
판독 모드(Readout mode)	프로그레시브 스캔(Progressive scan)
픽셀 등급	1.6 MP
해상도	1.58 Mpix
해상도 (h x v)	1456 x 1088 픽셀
중횡비	4:3
ADC	12 bit
색 심도(카메라)	12 bit
광학 센서 등급	1/3"
광학 영역	5.032 mm x 3.754 mm
광학 센서 대각선	6.28 mm (1/2.55")
픽셀 크기	3.45 μ m
마이크로 렌즈 시프트	0.00
제조사	Sony
센서 모델	IMX273LLR-C
게인(마스터/RGB)	24x/4x
AOI 수평	동일한 프레임 레이트
AOI 수직	프레임 레이트 증가
AOI 이미지 너비/단차 너비	256 / 8
AOI 이미지 높이/단차폭	1 / 1
AOI 위치 그리드(수평/수직)	8 / 1
수평 비닝	프레임 레이트 증가
수직 비닝	프레임 레이트 증가
빈닝 방법	모노
빈닝 요소	2
수평 서브샘플링	동일한 프레임 레이트
수직 서브샘플링	동일한 프레임 레이트
서브샘플링 방법	M/C 자동
서브샘플링 요소	2, 4, 8



모델

프레임 레이트 프리런 모드 (8비트 모드)	230 fps
프레임 레이트 트리거(연속)	230 fps
프레임 레이트 트리거(최대)	230 fps
노출 시간(최소 - 최대)	0.040 ms - 2000 ms
긴 노출(최대)	30606 ms
전력 소비	1 W - 2 W

주변 조건들

아래 주어진 온도 값들은 카메라 하우징의 외부 장치 온도를 나타냅니다.
PCB 버전들의 경우, 각각의 문서 내의 별도 힌트들을 참조하십시오.

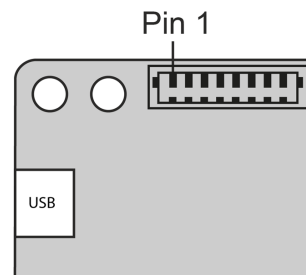
동작 중 장치 온도	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
보관 중 장치 온도	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
습도(상대, 비응축)	20 % - 80 %

커넥터들

인터페이스 커넥터
I/O 커넥터
전력 공급

핀 할당 I/O 커넥터

1	전압 출력 5V, 최대 400 mA
2	접지 (GND)
3	범용 I/O (GPIO) 2, 3.3 V - Line 3
4	범용 I/O (GPIO) 1, 3.3 V - Line 2
5	I2C 클럭 신호 - USB3 Vision 펌웨어 3.2 이상 필요
6	I2C 데이터 신호 - USB3 Vision 펌웨어 3.2 이상 필요
7	옵토커플러 없이 트리거 입력 3.3 V - Line 0
8	옵토커플러 없이 플래시 출력 3.3 V - Line 1
9	접지 (GND)
10	전압 출력 3.3 V



디자인

렌즈 마운트	CS- / C-마운트
IP 코드	-
치수 H/W/L	36.0 mm x 36.0 mm x 20.0 mm
무게	20 g

Features

Image Acquisition	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	✓
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	-
	Line scan highspeed	-
Flashing	Flashing	✓
	PWM flashing	-

기술적인 수정을 받아야 함 (2024-05-05)

2의 페이지 3

www.ids-imaging.kr

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

Image Adjustments	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
On-board Image Processing	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	-
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
Others	Chunks	-
	Sequencer	-
	Events	-
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2.20